



AMPMODU | AMPMODU 50/50 栅格

TE 内部编号 1-2267261-0

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 100 Position, 1.27 mm [.05 in] Centerline, Gold (Au), Through Hole - Solder, AMPMODU 50/50 Grid

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装母端

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

位数: 100

行数: 2

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

装载位置数量	100
PCB 安装方向	垂直
位数	100
行数	2

电气特征

端接电阻	12 mΩ, 14 mΩ, 16 mΩ
绝缘电阻	5000 MΩ
接触电阻	12 mΩ, 14 mΩ, 16 mΩ



介质耐压（最大值）300 VAC

主体特性

装配过程特性材料	铝合金
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子底板材料	镍
接合插针直径	.46 mm[.018 in]
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 μm[150 μin]
端子形状和构造	双, 矩形
端子布局	直插式
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	母端
端子额定电流（最大值）	.5 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.35 mm[.014 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.1 mm[.004 in]
端接柱体和尾部长度的	2.23 mm[.088 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合对准类型	极化公端
PCB 安装固定类型	压紧
PCB 安装对准类型	压紧
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

接合入口位置	顶部
--------	----



外壳材料	LCP
中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]

尺寸

行间距	1.27 mm[.05 in]
堆叠高度	6.35 mm, 8.12 mm, 9.9 mm[.25 in][.32 in][.39 in]
连接器宽度	3.05 mm[.12 in]
连接器高度	4.75 mm[.19 in]
连接器长度	63.91 mm[2.52 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]

使用环境

壳体温度额定值	高
工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

操作/应用

装配工艺特点	真空盖
电路应用	Signal

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476

包装特性

封装数量	1590
封装方法	卷带包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (13% in 4690971273)



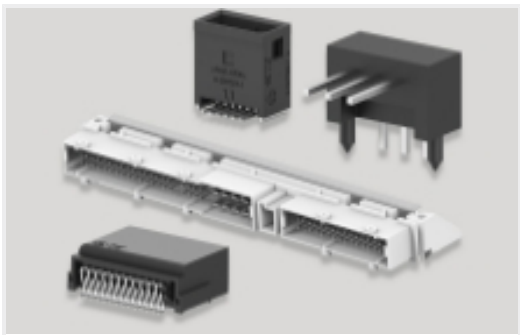
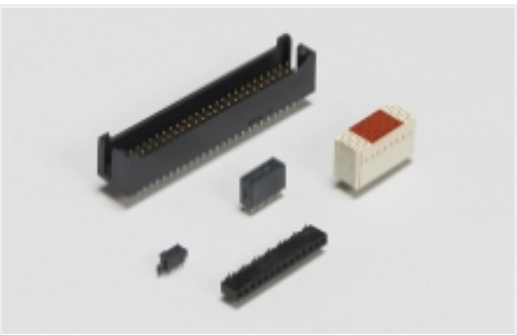
物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

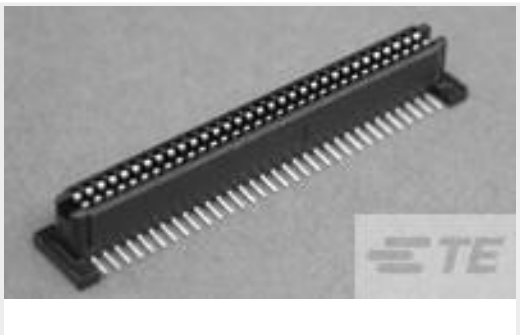
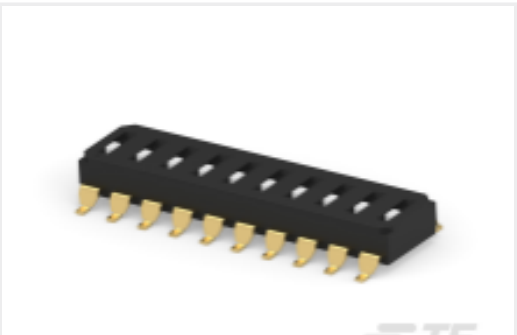
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | AMPMODU 50/50 栅格

 PCB 板端连接器及母端(193)	 带状电缆连接器(21)	 插入和拔出工具(1)	 板对板接头和插座(193)
 矩形电源连接器(12)	 连接器盖帽(7)		

客户还购买了

 TE 产品编号5-104076-2 60 SYS50 HDR DRST SHRD W/SL SN	 TE 产品编号5-103911-3 60 SYSTEM 50 RCPT ASSY DRRA	 TE 产品编号5146893-2 1FHR,84,30A/S,S,C,S08,09,10	 TE 产品编号3-2319848-1 END STACK DIP 10P G RECESS SEAL TUBE
---	---	---	--



TE 产品编号2176314-4
MELF SMA_A 180R 0.1% 15PPM 0102 0.3W

TE 产品编号3-1415020-1
PT570N20

TE 产品编号1-928836-2
MOD2 PIN WITH A-PIN L/P

TE 产品编号1-1437581-1
ASE22RL=AUTOSLIDE DP

TE 产品编号4-2176391-7
RQ 1206 37K4 0.1% 10PPM 5K RL

TE 产品编号7-2176246-6
CRGS2512 5% 1M8

文档

产品图纸

100 50/50 GRID DR TH/PIp RCPT VERT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2267261-0_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2267261-0_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2267261-0_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

AMPMODU 50/50 GRID THRU-HOLE

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

1-2267261-0

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 100 Position, 1.27 mm [.05 in]
Centerline, Gold (Au), Through Hole - Solder, AMPMODU 50/50 Grid



英文版本